



DPAK 封装型式

1、D-PAK 是一种塑封贴片封装，常用于功率晶体管、稳压芯片的封装，是目前主流封装之一。



2、采用该封装方式的 MOSFET 有 3 个电极，栅极 (G)、漏极 (D)、源极 (S)。



3、其中漏极 (D) 的引脚被剪断不用，而是使用背面的散热板作漏极 (D)，直接焊接在 PCB 上，一方面用于输出大电流，一方面通过 PCB 散热；所以 PCB 的 D-PAK 焊盘有三处，漏极 (D) 焊盘较大。其封装规范如下：



Unit: mm

